|  |  |
| --- | --- |
| **Oficina de Normalizaciónde las Telecomunicaciones** | **logo_S_** |
|  |  |

 Ginebra, 11 de julio de 2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ref.:Tel.:Fax: | **Circular TSB 206**COM 15/GJ+41 22 730 6356+41 22 730 5853 | - A las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión- A los Miembros del Sector UIT‑T; |
| Correo-e: | tsbsg15@itu.int  | **Copia**:- A los Asociados del UIT‑T;- A las Instituciones Académicas del UIT-T;- Al Presidente y a los Vicepresidentes de laComisión de Estudio 15;- Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones;- Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones |

|  |  |
| --- | --- |
| Asunto: | **Supresión de la Recomendación UIT-T L.16** |

Muy Señor mío:

1 Por la Circular TSB 180 del 8 de abril de 2011, se propuso suprimir la citada Recomendación, a petición de 26 Estados Miembros y 65 Miembros de Sector participantes en la reunión de la Comisión de Estudio 15 (Ginebra, 14 al 25 de febrero de 2011) y de conformidad con las disposiciones de la Recomendación A.8, § 8.2, de la AMNT (Johannesburgo, 2008).

2 El 8 de julio de 2011, se cumplieron las condiciones de supresión de esta Recomendación.

Una Administración de un Estado Miembro ha respondido a la consulta, y no se recibió ninguna objeción a la supresión.

Queda, por tanto, suprimida la **Recomendación UIT-T L.16**, *Material plástico conductor como revestimiento protector para cubiertas metálicas de cable*.

Atentamente.

Malcolm Johnson
Director de la Oficina de
Normalización de las Telecomunicaciones